

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 79100543.2

51 Int. Cl.²: **H 01 L 21/60**
H 01 L 23/48

22 Anmeldetag: 23.02.79

30 Priorität: 27.03.78 US 890445

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.10.79 Patentblatt 79/20

88 Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: 17.10.79

84 Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

71 Anmelder: **International Business Machines Corporation**

Armonk, N.Y. 10504(US)

72 Erfinder: **Joshi, Kailash Chandra**
963 South Pines Drive
Endwell, New York 13760(US)

72 Erfinder: **Spaight, Ronald Neil**
309 Burd Drive
Vestal, New York 13850(US)

74 Vertreter: **Kirchhof, Norbert, Ing. grad.**
Schönaicher Strasse 220
D-7030 Böblingen(DE)

54 **Verfahren zum Verbinden einer ersten integrierten Schaltungsvorrichtung mit einer Anzahl von Verbindungspunkten mit einer zweiten integrierten Schaltungsvorrichtung.**

57 Bei einem Verfahren zum Verbinden einer ersten integrierten Schaltungsvorrichtung mit einer Anzahl von Verbindungspunkten mit einer zweiten integrierten Schaltungsvorrichtung wird eine Mehrzahl von Kupferstiften auf einem Chipträger (11) durch Plattieren gebildet, und zwar in einem Muster, das mit den als elektrische Anschlußstellen dienenden Puffern (25) eines Chips (23) übereinstimmt. Auf die Puffer (25) wird eine kleine Menge Lötmittel aufgebracht. Der Chipträger (11) und das Chip (23) werden so gegeneinander ausgerichtet, daß die Kupferstifte (19) mit den zugeordneten Puffern (25) ausgerichtet sind. Schließlich wird auf den Chipträger (11) und das Chip (23) ein Druck und eine Temperatur ausgeübt, daß jeder der Kupferstifte (19) mit dem zugeordneten Puffer (25) eine Verbindung eingeht.

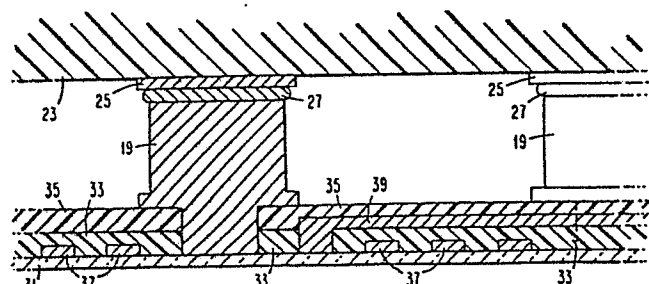


FIG. 2



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0004289

Nummer der Anmeldung

EP 79 10 0543

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl. ²)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	<p><u>US - A - 3 517 278 (TELEDYNE)</u> * Figur 3; Spalte 2, Zeilen 27-62 *</p> <p>--</p> <p>IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Vol. 20, Oktober 1977, New York, A.J. FERRARO et al.: "Joint reliability using a plated copper stud", Seite 1722 * Figur; Absatz 1 *</p> <p>--</p> <p><u>US - A - 4 078 980 (NATIONAL SEMICONDUCTOR)</u> * Figur 1; Spalte 2, Zeile 62 - Spalte 3, Zeile 31 *</p> <p>--</p> <p><u>US - A - 3 993 515 (RCA)</u> * Figur 1; Ansprüche 1,4 *</p> <p>--</p> <p><u>DE - A - 1 954 135 (LICENTIA)</u> * Figur 3; Ansprüche 1,4,8 *</p> <p>----</p>	<p>1-3</p> <p>1,2,4,5</p> <p>1,4,5,7</p> <p>1,4,5</p> <p>1,6,7</p>	<p>H 01 L 21/60 23/48</p> <p>RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.²)</p> <p>H 01 L 21/60 23/54 23/14</p> <p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>
X	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		26-06-1979	DE RAEVE